

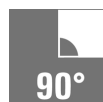
RJ45C5 S1D 2.7N4N RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'assortimento prodotti include i seguenti modelli:

- 90° orizzontale e 180° verticale
- Con gancio verso l'alto / gancio verso il basso
- Processi di saldatura THT, THR o SMD
- Ampia gamma di forme diverse, anche con LED integrati e linguette per contatto schermato
- Categoria di prestazione da Cat. 3 a Cat. 6
- Versione con imballaggio in vassoio (TY) o su rotolo (Tape-on-Reel, RL)
- Compatibile con connettore RJ45 modulare secondo ANSI / TIA-1096-A e IEC 60603
- Rigidità dielettrica ≥ 1500 V AC RMS (valore di picco 2250 V AC) secondo IEEE 802.3
- Rigidità dielettrica ≥ 1500 V AC (valore di picco) ≥ 1500 V DC secondo IEC 60603

Caratteristiche e vantaggi:

- Intervallo di temperatura ampliato da -40 °C a $+85$ °C per massime prestazioni
- Strato dorato rinforzato (30μ) per una migliore protezione anticorrosione
- La distanza di almeno 0,3 mm assicura una perfetta saldatura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore per circuito stampato, Jack RJ45, Cat. 5, Collegamento a saldare SMD, 90°, Opzione Latch: basso, Linguette di schermatura: nessuno, 30...80 μ m Ni / ≥ 30 μ m Au, LED: No, Numero di poli: 8, Tape
N. d'ordine	1433890000
Tipo	RJ45C5 S1D 2.7N4N RL
GTIN (EAN)	4050118238471
CPZ	260 Pezzo
Imballaggio	Tape

RJ45C5 S1D 2.7N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	18,7 mm	Profondità (pollici)	0,736 inch
Posizione verticale	16,88 mm	Altezza (pollici)	0,665 inch
Altezza minima	11,8 mm	Larghezza	18,5 mm
Larghezza (pollici)	0,728 inch	Peso netto	0,007 g

Specifiche di sistema

Angolo di uscita	90°	Cablaggio	8 poli
Categoria	Cat. 5	Categoria di prestazione	Cat. 5
Cicli di inserimento	750	Complanarità:	100 µm
Dimensioni del codolo a saldare	ottagonale	Famiglia prodotti	OMNIMATE Data - Jack modulare RJ45
Grado di protezione	IP20	LED	No
Linguette di schermatura	nessuno	Lunghezza spina a saldare (l)	3,5 mm
Materiale della schermatura	Lega di rame	Montaggio su circuito stampato	Collegamento a saldare SMD
Numero di codoli a saldare per polo	1	Numero di poli	8
Opzione Latch	basso	Passo in mm (P)	1,27 mm
Passo in pollici (P)	0,05 "	Processo di saldatura	Saldatura Reflow, Saldatura manuale
Schermatura	Sì	Superficie di schermatura	nichelato
Tipo di collegamento	Collegamento a saldare SMD	Tolleranza della posizione del codolo a saldare	± 0,1 mm

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	1,5 A	PoE / PoE+	secondo IEEE 802.3at
Resistenza contro l'isolamento	≥ 500 MΩ	Rigidità dielettrica contatto-contatto	1000 V DC
Rigidità dielettrica contatto-schermo	1500 V DC	Tensione nominale	125 V

Standard

Connettori a norma	IEC 60603-7-51
--------------------	----------------

Dati del materiale

Materiale isolante	PA 9T	Colori	nero
Tabella dei colori (simile)	RAL 9011	Gruppo materiali isolanti	II
Comparative Tracking Index (CTI)	≥ 500	Resistenza contro l'isolamento	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Materiale base dei contatti	Fosforo bronzo	Materiale dei contatti	Lega in rame
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Struttura a strati del connettore maschio	30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au
Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C	Temperatura di magazzinaggio, max.	85 °C
Temperatura d'esercizio, min.	-40 °C	Temperatura d'esercizio, max.	85 °C

Imballaggio

Imballaggio	Tape	Lunghezza VPE	355 mm
Larghezza VPE	346 mm	Altezza VPE	131 mm
Diametro Ø bobina nastro (A)	330 mm	Resistenza superficiale	Rs = 10 ⁹ - 10 ¹² Ω

RJ45C5 S1D 2.7N4N RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01
ECLASS 14.0	27-46-02-01		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

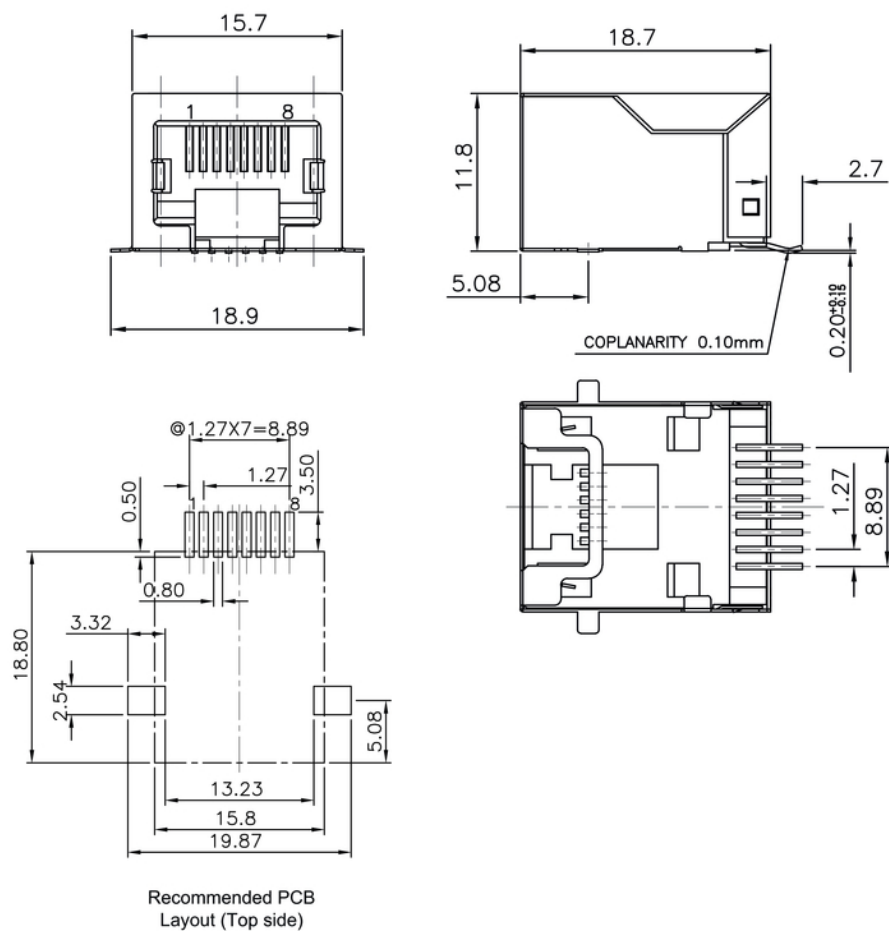
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Certificate of Compliance
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

RJ45C5 S1D 2.7N4N RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Disegni****Dimensional drawing**

RJ45C5 S1D 2.7N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

RJ45	G	I	R	U	3.2	E	4	G/Y/GY	TY	RJ45G I RJ19 3.2E4GY/GY TY

Legenda

Data di creazione 18 settembre 2024 13.19.41 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.